

特 許 協 力 条 約

PCT

REC'D 22 JUL 2004

WIPO

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)
〔PCT36条及びPCT規則70〕

出願人又は代理人 の書類記号 M03-G-179CT1	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知（様式PCT/ IPEA/416）を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP03/08884	国際出願日 (日.月.年) 14.07.2003	優先日 (日.月.年) 04.02.2003
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. ⁷ H01L 21/82, H01L 27/04, H01L 21/3205, G06F1/04		
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で <u>3</u> ページからなる。 <input checked="" type="checkbox"/> この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で <u>2</u> ページである。
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 I <input checked="" type="checkbox"/> 国際予備審査報告の基礎 II <input type="checkbox"/> 優先権 III <input type="checkbox"/> 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 IV <input type="checkbox"/> 発明の単一性の欠如 V <input checked="" type="checkbox"/> PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI <input type="checkbox"/> ある種の引用文献 VII <input type="checkbox"/> 国際出願の不備 VIII <input type="checkbox"/> 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 21.11.2003	国際予備審査報告を作成した日 29.06.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 棚田 一也	4L 9361
電話番号 03-3581-1101 内線 3498		

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
 PCT規則70.16, 70.17)

☐ 出願時の国際出願書類

- ☒ 明細書 第 1-17 ページ、出願時に提出されたもの
 明細書 第 _____ ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

- ☒ 請求の範囲 第 3, 5-12 項、出願時に提出されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、PCT19条の規定に基づき補正されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 請求の範囲 第 2, 4 項、04.03.2004 付の書簡と共に提出されたもの

- ☒ 図面 第 1-13 ~~ページ~~図、出願時に提出されたもの
 図面 第 _____ ページ/図、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 図面 第 _____ ページ/図、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

- ☐ 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、出願時に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
☒ 請求の範囲 第 1 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)	請求の範囲 2-12	有
	請求の範囲	無
進歩性(IS)	請求の範囲 2-12	有
	請求の範囲	無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 2-12	有
	請求の範囲	無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

- 文献1: JP 2002-043516 A (東芝マイクロエレクトロニクス株式会社)
2002.02.08
- 文献2: JP 02-209735 A (セイコーエプソン株式会社)
1990.08.21
- 文献3: JP 2001-244414 A (日本電信電話株式会社)
2001.09.07
- 文献4: JP 2000-076140 A (日本電信電話株式会社)
2000.03.14
- 文献5: WO 00/28399 A1 (INFINEON TECHNOLOGIES AG)
2000.05.18

請求の範囲2乃至3について

請求の範囲2乃至3に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1乃至5に対し新規性、進歩性を有する。

シールド配線層に「切替回路」を設けることは、上記文献のいずれにも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

請求の範囲4乃至6について

請求の範囲4乃至5に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1乃至5に対し新規性、進歩性を有する。

物理的な改変を防止するシールド配線層を、互いに交差する上部シールド配線と下部シールド配線とで構成することは、上記文献のいずれにも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

請求の範囲7乃至12について

請求の範囲7乃至12に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1乃至5に対し新規性、進歩性を有する。

「シールド配線」を「集積回路を構成する配線」と斜めに交差させる構成は、上記文献のいずれにも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

請求の範囲

1. (削除)

2. (補正後) 集積回路と、

前記集積回路の上に形成され、前記集積回路に対する物理的な改変を防止するシールド配線層とを備え、

前記シールド配線層は、下部シールド配線と該下部シールド配線の上に形成された上部シールド配線とを含み、

前記下部シールド配線と前記上部シールド配線との各配線の配置方向は互いに交差しており、

前記下部シールド配線及び上部シールド配線はそれぞれ複数からなり、

前記複数の下部シールド配線又は前記複数の上部シールド配線のうちの少なくとも2本を電氣的に接続すると共に、その接続先を変更できる切替回路をさらに備えている半導体集積回路装置。

3. 請求項2において、

前記切替回路を複数備え、

前記複数の切替回路は、前記集積回路の上に互いの間隔が不規則となるように設けられている半導体集積回路装置。

4. (補正後) 集積回路と、

前記集積回路の上に形成され、前記集積回路に対する物理的な改変を防止するシールド配線層とを備え、

前記シールド配線層は、下部シールド配線と該下部シールド配線の上に形成された上部シールド配線とを含み、

前記下部シールド配線と前記上部シールド配線との各配線の配置方向は互いに交差しており、

前記下部シールド配線又は前記上部シールド配線のうちの少なくとも一方は、

18/1

電源線、接地線又は前記集積回路を制御する信号線と接続する接続部を有している半導体集積回路装置。

5. 請求項4において、

前記接続部は、前記下部シールド配線又は前記上部シールド配線のうちの少なくとも一方に複数設けられ、

前記複数の接続部は、前記集積回路の上に互いの間隔が不規則となるように